

Leistungselektronik braucht intelligente Lösungen.

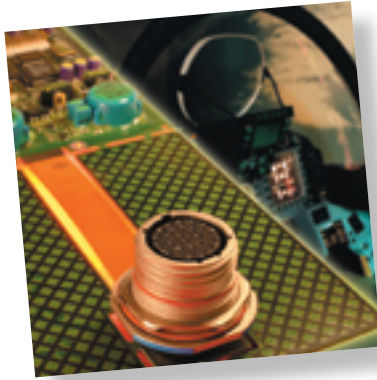
The GED logo consists of the letters 'GED' in a bold, white, sans-serif font, set against a red square background with a slight 3D effect and a white shadow.

Der GED Technologie-Baukasten für Hochstrom-Elektronik

A close-up photograph of a red, rectangular GED Powermodul C2100. The module has a ribbed top surface with several circular holes. A large brass terminal is visible on the right side, and a smaller silver terminal is also present. The text 'GED Powermodul C2100' is printed on the front edge. In the background, a circular component with 'EMER' and 'S' is partially visible.

GED Powermodul C2100

GED. Wir sorgen für starke Verbindungen.



Die Zukunft der Antriebstechnik und Energieversorgung hat schon begonnen!

Wir setzen Ihre Leistungselektronik-Projekte mit modernsten Aufbau- und Verbindungslösungen um. Ihre Schaltungstechnik verpacken wir in ein maßgeschneidertes Design.

Neue Hochstrom-Konzepte für Ihre Leistungselektronik

Die Kombination von Packaging, Entwärmung, Montage- und Anschlusstechniken mit neuen μ C-basierten Ansteuerungen sind dabei der Schlüssel, um für Sie innovative, kostenoptimale Produkte zu realisieren.

Leiterplatten – optimaler Lagenaufbau für effiziente Entwärmung und Isolation

Der GED-Technologiebaukasten bietet Ihnen – je nach Leistungs-klasse und Anwendung – verschiedene Arten von Hochstrom-Leiterplatten. Für die effektive Entwärmung und optimale elektrische Isolation.

Bauteile ansteuern – mit erprobten Hard- und Softwaremodulen

Um LEDs, MOSFETs und andere Bauteile anzusteuern, setzt GED erprobte Hardware- und Software-Module ein. Integrierbar sind u. a. PWM, OPEN LOAD DETECTION, Strom- und Temperaturmessung, sowie verschiedene Bussysteme z.B. CAN- oder LIN-Bus.



GED. Wir sorgen für starke Verbindungen.

Anschluss- und Gehäusetechnik – passend zu Leistungskategorie und Anwendung

Auch bei der Anschluss- und Gehäusetechnik sind die Hochstrom-Entwicklungen variabel: GED verfügt über unterschiedliche, neuartige Anschlusselemente und Gehäuse aus thermisch hochleitendem Kunststoff oder aus Aluminium.

Hochstrom-Komplettservice – Thermo-Konzept, Entwicklung, Design, Fertigung

Der GED Hochstrom-Komplettservice bietet Ihnen optimierte Entwicklungs- und Designlösungen, verbunden mit hoher Termintreue – inklusive Qualitäts- und Systemprüfung im GED-eigenen Hochstromlabor:

- von der Beratung und thermischen Konzeption, basierend auf einer Thermo-Simulation,
- über die Anslusstechnik und den mechanischen Aufbau inklusive Housing,
- die Entwicklung und das Design der Hochstrom-Lösung
- bis hin zum Test sowie zur Leiterplatten-Produktion und Bestückung.

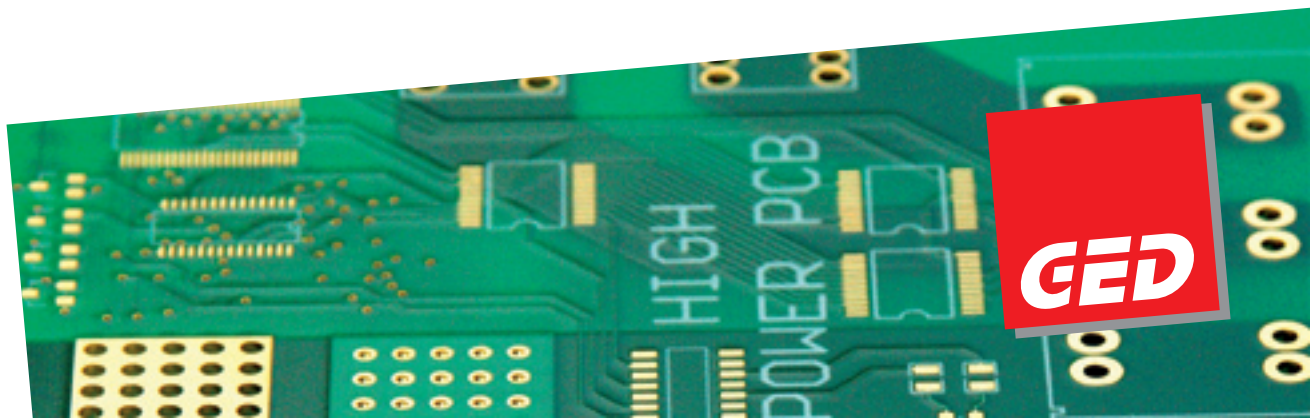
Nutzen Sie den GED Technologie-Baukasten für optimale Hochstrom-Lösungen!

400 A

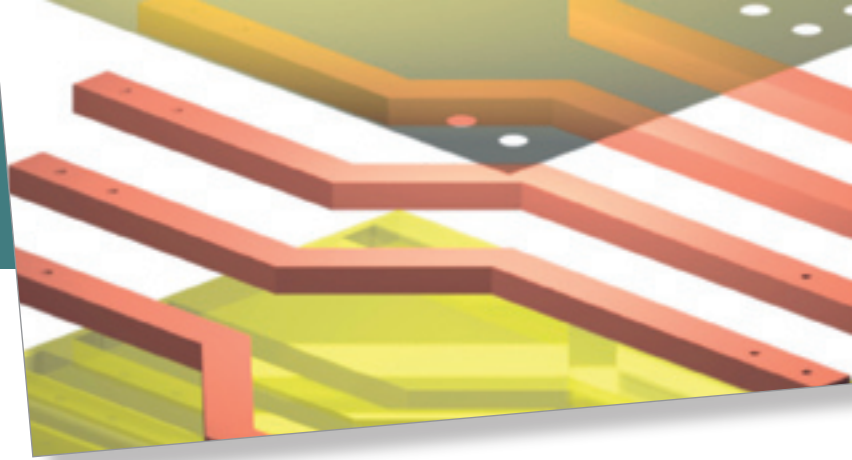
200 A

100 A

50 A



Leistungssteigerung.
Kostenoptimierung.
Höhere Zuverlässigkeit.



GED. Erwarten Sie einfach mehr.

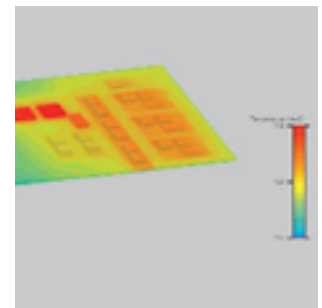
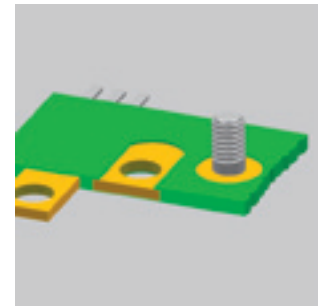
- Leiterplatten- und Verbindungslösungen für Ihre Leistungselektronik
- Beratung, Entwicklung und Design, Simulation und Test, Baugruppen und Fertigung
- Anschlusstechnik, Entwärmung und Hochstromführung
- Kontaktloses Schalten und intelligente Powermodule

Power-Elektronik für Lichttechnik, Antriebstechnik, Automotive, Telekommunikation, Haushaltsgeräte- und Umwelttechnik



GED – Gesellschaft für Elektronik und Design mbH
Pastoratsstrasse 3
53809 Ruppichteroth-Winterscheid

Telefon: +49 (0) 22 47 - 92 19-0
Telefax: +49 (0) 22 47 - 92 19-50
E-Mail: ged@ged-pcb-mcm.de
Internet: www.ged-pcb-mcm.de



GED. High power, high density, high speed.